

**Kontaktdaten**

Firma

Ansprechpartner

Anschrift

Abteilung

Telefon

E-Mail

**Produkt | Baugruppe**

Beschreibung

Liefermenge

Artikel-Nr.

Liefertermin

**Materialbeschaffung | Materialbeistellung**

Durch uns ja nein

Material 100% Beistellung ja nein

siehe Stückliste ja nein

Leiterplatte wird beigestellt ja nein Bitte PDF Leiterplattenspezifikation anfordern

**Entwicklung**

Hardware ja nein

Software ja nein

**Fertigung von**

a.) einer Baugruppe ja nein

b.) einem Komplettgerät ja nein  
(Baugruppe plus Gehäuse)**Fragen zur Leiterplatte**

Anzahl der Lagen

Anzahl der Leiterplatten im Nutzen

Abmessungen der Einzelplatine L x B x H in mm

gefräste Konturen

Bestückungsdruck

<b>Bestückungstechnologie</b>					
Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
SMD Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
THT Bestückung	ja	nein	einseitig	zweiseitig	
Bestückungsdruck	ja	nein	einseitig	zweiseitig	

  

<b>Löten von THT Bauteilen</b> (Mehrfachnennungen möglich)					
selektivgelötet	ja	nein			
wellengelötet	ja	nein			
handgelötet	ja	nein			

  

<b>Prüfung</b>					
Optische Prüfung mit „Quins“	ja	nein			
AOI	ja	nein			
Elektrische Prüfung	ja	nein			
BGA-Inspektion	ja	nein			

  

<b>Prüfung</b>					
Zukaufteil (Beistellung)	ja	nein			
Fertigung durch Baudisch	ja	nein			
Abmessungen L x B x H in mm		x		x	
Material	AL	pulverbeschichtet	RAL-Farbe		
	V2A				
	V4A				

  

<b>Datenbereitstellung</b>					
Stückliste	Bestückungsplan		Schablonendaten		
Gerberdaten der LP	Zeichnungen		Fotos		
Koordinatenliste					

  

<b>Bemerkungen</b>					

**Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung**

Vertrieb	Tel. +49 71 72 926 13-0
Entwicklung	Tel. +49 71 72 926 13-52

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:  
**vertrieb@baudisch.de**